



Baumit Baumacol FlexTop

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek,
klasa C2TES1

Korzyści

- najwyższa trwałość na tarasach
- klejenie na stare płytki
- długi czas gotowości do pracy



Produkt

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa na bazie szarego cementu o wydłużonym czasie otwartym, do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Posiada certyfikat EMICODE EC 1 PLUS.

Właściwości

Wysokoelastyczna, wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie wiążąca, ulepszona, tiksotropowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa, o podwyższonej wytrzymałości na odkształcenia poprzeczne.

Przeznaczenie

Do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych każdego typu i formatu, mozaiki, płytek gresowych oraz płyt z włókna szklanego, lekkich płyt budowlanych oraz twardych płyt styropianowych. Nadaje się do stosowania na podłożach odkształcalnych i o podwyższonych wymaganiach, w obrębie pomieszczeń mieszkalnych (w tym na ogrzewanie podłogowe) oraz budynków użyteczności publicznej, tarasów, elewacji, basenów i zbiorników wodnych. Dopuszczona do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Dane techniczne

Produkt	
Klasyfikacja:	C2TE S1 wg PN-EN 12004:2002
Czas korekty:	do 5 min.
Min. grubość warstwy:	2 mm
Max. grubość warstwy:	10 mm
Czas otwarty:	do 30 min.
Czas dojrzewania:	ok. 15 min.
Czas obróbki:	do 4 godz.

Wariant(y)	FlexTop 25 kg
Zużycie	ok. 3 kg/m ² /mm
Zapotrzebowanie wody	ok. 6 l/25kg

Paca zębata:	3 mm	6 mm	10 mm
Zużycie około:	1,5 kg/m ²	2,5 kg/m ²	3,5 kg/m ²



Opakowanie	Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg
Przechowywanie	W suchym i chłodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl
Podłoże	Podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, wolne od wykwitów, nośne i pozbawione luźnych cząstek. Zaprawę można stosować na: beton, jastrych, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe i gipsowe, kartonowe płyty gipsowe, gipsowe ścienną płytę budowlaną, jastrychy anhydrytowe (odpowiednio zagruntowane). Nie stosować na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesów wiązania.
Przygotowanie podłoża	Podłoże oczyścić z pyłu, kurzu, oraz zagruntować odpowiednim preparatem : w przypadku podłoży chłonnych - Baumit Grund, w przypadku podłoży niechłonnych - Baumit SuperPrimer.
Obrobka	<p>Zalecane narzędzia: Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca zębata, kielnia, gąbka paca 3 x 3 mm - klejenie mozaiki paca 6 x 6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim paca 10 x 10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym</p> <p>Wysypać zawartość worka do odpowiedniej ilości czystej wody i mieszać przez ok. 3 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać ok. 5 minut i ponownie przemieszać zaprawę. Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie na podłoże (pacę utrzymywać podczas rozprowadzania materiału pod kątem 45 stopni do podłoża). Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.</p> <p>Zalecane pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienie przestrzeni podpłytkowej):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wewnątrz budynków > 65% ■ na zewnątrz budynków oraz przy ogrzewaniu podłogowym > 90% <p>Zapewnienie pełnego kontaktu płytki z klejem można otrzymać poprzez układanie płytek metodą kombinowaną (BUTTERING - FLOATING), polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na spód płytki.</p> <p>Przez ok. 48 godzin chronić klejoną powierzchnię przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi (nie chodzić i nie obciążać ułożonych płytek).</p>
Wskazówki	<p>Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża i okładzin.</p> <p>Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C lub powyżej +25°C, w deszczu, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Chronić do czasu pełnego utwardzenia.</p> <p>Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają przewidziany czas schnięcia, wysokie temperatury skracają czas wiązania i utwardzania!</p> <p>Nie dodawać żadnych innych materiałów!</p> <p>Nie moczyć ani podłoża ani płytek.</p> <p>Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu otwartego - schnięcia naniesionej na podłoże zaprawy klejowej. Po przekroczeniu tego czasu zaprawę należy usunąć.</p>

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przechowywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.